

# 芯片行业“双爆发”时刻

解读 2026 年核心机遇与投资逻辑

北京研精毕智信息咨询有限公司

# 目录

市场核心事件

1

核心企业格局

3

2

细分赛道展望

4

核心驱动因素

# 市场核心事件

近期，全球芯片市场标志性事件频发，国际巨头与 A 股板块共振，预示行业进入全新爆发周期。

# AMD 业绩股价双爆发

## 国际巨头领跑，数据中心成增长核心

01

### 一季度营收超预期

2026 年 Q1，AMD 营收达 102.5 亿美元，同比增长 38%，其中数据中心业务贡献了 58 亿美元，成为核心增长驱动力。

02

### 二季度指引更亮眼

公司预计 Q2 营收将达 112 亿美元，远超市场预期的 105.2 亿美元，展现出强劲的增长势头。

03

### 股价市场表现强劲

受业绩提振，AMD 股价单日暴涨 16%，过去一年涨幅超 200%，2026 年年内涨幅亦高达 66%。

# A 股芯片板块集体沸腾

## 资金汹涌，细分赛道领涨市场



1

### 半导体指数大涨

A 股半导体指数单日上涨 7.2% ，市场情绪高涨，23 只个股涨停，超百只个股涨幅超过 5% 。

2

### 细分赛道领涨

AI 芯片 ( +9.8% )、先进封装 ( +8.5% )、半导体设备 ( +7.9% ) 等细分领域表现尤为突出。

3

### 资金净流入超百亿

龙头股如北方华创、中芯国际、寒武纪等成交量较前一日翻倍，单日资金净流入超 120 亿元。

4

### 估值反映成长预期

当前板块平均 PE ( TTM ) 为 68 倍，虽高于 A 股整体，但较历史峰值仍有提升空间，反映市场对国产芯片产业的高成长预期。

# 全球市场复苏信号明确

## 整体市场规模触底反弹，进入新增长周期

01

### 市场规模止跌回升

2026 年 Q1，全球芯片市场规模达 1280 亿美元，同比增长 19%，结束了连续三个季度的负增长。

02

### 增长主力领域明确

数据中心芯片（+34%）、汽车半导体（+28%）、工业芯片（+17%）成为市场复苏的主要拉动力。

03

### 区域格局变化

亚太地区（不含日本）占比达 58%，中国市场贡献核心增量；北美市场占比 24%，受益于算力芯片爆发。

04

### 未来市场空间广阔

预计 2026 年全球数字芯片市场规模将突破 9750 亿美元，2023-2026 年复合增长率超 18%，AI 芯片贡献超 60% 的行业增速。



## 细分赛道展望

AI 浪潮、国产替代与先进封装技术共同作用，催生产业链各环节的结构性机遇。

# AI 芯片：双轮驱动

## 高端算力与边缘计算需求共振

1

### 高端 AI 芯片供不应求

随着大模型参数规模扩大，对高端 AI 芯片的算力、显存带宽要求不断提升，英伟达 H100、AMD MI300 等芯片持续缺货。

2

### 全球市场规模预测

预计 2026 年全球 AI 芯片市场将达 2800 亿美元，国内企业如寒武纪、壁仞科技等在高端领域的突破有望带来超额收益。

3

### 边缘 AI 芯片快速增长

边缘计算场景对低功耗、低成本 AI 芯片的需求持续增长，地平线征程 6、黑芝麻 A1000 等芯片已实现批量装车。

4

### 边缘市场空间

预计 2026 年边缘 AI 芯片市场规模将达 230 亿美元，同比增长 56%，相关企业将受益于智能汽车与物联网的协同增长。

# 设备材料：国产替代

## 半导体产业链安全的核心环节

### 01.

#### 核心设备国产化

14nm 及以下先进工艺设备是国产化重中之重，刻蚀机、光刻机、沉积设备等需求迫切，北方华创、中微公司技术持续突破。

### 02.

#### 材料国产化率低

抛光液、光刻胶、靶材等半导体材料的国产化率普遍低于 30%，安集科技、上海新阳、江丰电子等企业已在细分领域实现突破。

### 03.

#### 替代空间巨大

随着国内晶圆厂产能扩张，半导体设备与材料企业的营收与利润有望持续增长，是国产化替代中确定性最高的赛道之一。

# 先进封装：性能关键

## 提升芯片性能与集成度的核心技术

### 01 封装技术重要性

先进封装技术（如 Chiplet、CoWoS）能够有效提升芯片的算力与能效比，是高端 AI 芯片不可或缺的一环。

### 02 国内技术进展

长电科技、通富微电、华海清科等国内企业已掌握 Chiplet 封装技术，并正积极推进 CoWoS 等更先进技术的研发。

### 03 市场规模爆发在即

随着国际巨头及国内 AI 芯片企业对先进封装需求的增长，预计 2026 年国内先进封装市场规模将达 180 亿美元，同比增长 62%。

# 核心企业格局

国际巨头围绕算力展开激烈竞争，国内企业则在细分领域加速实现技术突破。

# 国际巨头算力争霸

## AMD 与英伟达的竞争推动行业创新

### AMD 后发制人

凭借 MI300 系列 AI 芯片，AMD 在高端 AI 芯片市场的份额同比提升 11 个百分点至 18%，其芯片在大模型训练场景中展现出 25% 的性价比优势。

### 英伟达生态壁垒

尽管面临冲击，英伟达一季度数据中心业务营收仍达 221 亿美元，H100 芯片出货量超 120 万片，全球市占率维持在 70% 以上，CUDA 生态是其核心护城河。

### 业务多元化布局

英伟达加速布局边缘计算芯片和自动驾驶领域，一季度汽车业务营收同比增长 56%，成为新的增长曲线。

# A 股企业加速突破

## 国产化替代在多环节取得实质性进展

01

### 芯片设计环节

寒武纪思元 400 芯片支持大模型训练，已进入百度、阿里供应链；兆易创新推出 DDR5 内存芯片，打破三星、SK 海力士的垄断。

02

### 芯片制造环节

中芯国际 14nm 工艺产能利用率维持在 95% 以上，并正在推进 N+2 工艺（等效 7nm）量产，良率已达 60%。

03

### 设备材料环节

北方华创的 14nm 刻蚀机、中微公司的 5nm 刻蚀机已通过中芯国际验证；安集科技的抛光液产品在 14nm 工艺中渗透率超 30%。

# 核心驱动因素

AI 算力需求、国产化替代进程与下游应用场景拓展共同构成了行业爆发的核心动力。

# AI 算力需求指数级增长

## 大模型训练与推理驱动算力基建狂潮

1

### 全球算力支出激增

预计 2026 年全球 AI 算力支出将达 1890 亿美元，同比增长 83%，ChatGPT-4 等大模型的参数规模已突破万亿级。

2

### 芯片供不应求

AMD MI300、英伟达 H100 等高端芯片交货周期延长至 6-9 个月，HBM 封装专用刻蚀设备因 TSV 通孔需求暴增，订单已排至 2028 年。

# 国产化替代进入快车道

## 政策与市场双轮驱动，替代空间巨大

01

### 芯片自给率提升

2026 年一季度，国内芯片自给率已提升至 32%，其中 14nm 及以下先进工艺自给率达 15%，同比均有显著提升。

02

### 政策资金支持

国家集成电路产业投资基金（大基金三期）已募资超 3500 亿元，重点支持先进工艺、半导体设备、高端芯片设计等领域。

03

### 巨大替代空间

当前半导体设备国产化率仍不足 20%，材料国产化率普遍低于 30%，巨大的替代空间成为行业增长的核心动力。

# 下游应用场景持续拓展



## 汽车、工业、物联网等市场提供新增量

01

### 汽车半导体市场

2026年Q1全球新能源汽车销量同比增长35%，带动汽车半导体市场规模同比增长28%。

02

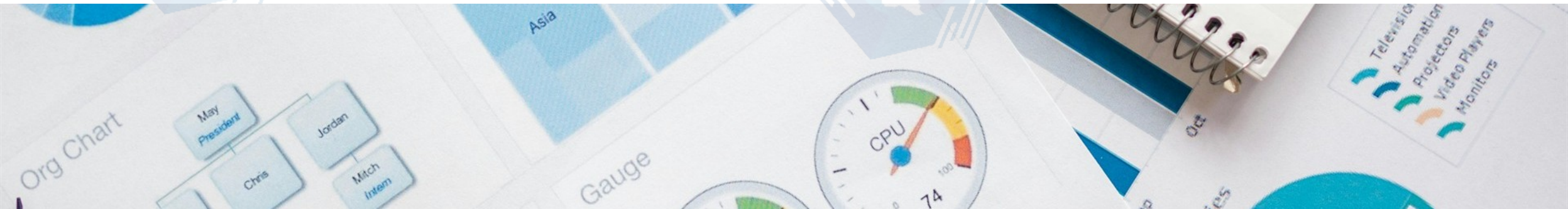
### 工业与物联网芯片

工业互联网、智能制造等场景对工业芯片的需求同比增长17%；全球物联网设备连接数突破300亿台，带动低功耗物联网芯片需求同比增长22%。

03

### 新兴场景涌现

生物芯片、Mini/MicroLED等正成为芯片需求的新增长点，其中生物芯片刻蚀设备年增速高达35.8%。



## 分析师声明

负责本研究报告的分析师在本报告中所采用的数据均来自合规渠道，报告的观点、逻辑和论据均为分析师本人研究成果，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

## 公司声明

本报告的著作权归北京精毕智信息咨询有限公司（简称为“研精毕智”）所有。本报告是研精毕智研究与统计成果，所载的观点、结论

和建议仅代表行业基本状况，仅为市场及客户提供基本参考。  
本报告调研方法主要是桌面研究、行业访谈等，结合公司内部逻辑算法，通过定量和定性分析分析，客观阐述行业的现状，科学预测

行业未来的发展趋势。  
我们力求报告内容客观、公正，但受到调研方法及调查资料收集范围的局限，本报告所述的观点、数据并不一定完全准确。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式篡改、复制和发布。如引用、转载需注明出处，且不得

对本报告进行有悖原意的引用和修改。  
本研究报告仅供北京研精毕智信息咨询有限公司客户和经本公司授权机构的客户使用，未经授权私自刊载的机构以及其阅读和使用

应慎重使用报告，本公司不承担由此所产生的相关风险和责任。